

メッキ用通電性ダミーボール

- ・チップ抵抗、チップコンデンサーなどの受動部品のメッキ工程に使用されています。先端メッキ工程に使用される0.5mm以下の微小ボールも取り扱っています。

■ 特長

- ・高精度、高信頼性。
- ・複数選別により、異形混入が少ない。
- ・現行品（0.4mm）の混入実力値（ppm）：1,000～3,000ppm。



■ 標準仕様

項目	仕様
材質	炭素鋼、ステンレス鋼
ボール径	0.2～1.0mm
寸法公差	+0.1mm
メッキ仕様	銅、ニッケルベース+錫
メッキ厚	0.5μm以上

注記)

- ・特殊なサイズ、材料、メッキ仕様にも対応致します。

DSC Corporation

■ 製品の詳細については、下記にお問合せ下さい。

東京	〒112-0006 東京都文京区小日向4丁目2番8号 大樹生命文京小日向ビル2階 TEL : 03-5981-9461 FAX : 03-5981-9462 E-MAIL : info@dsc.co.jp
大阪	〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山1丁目7番20号 TEL : 06-6115-8560 FAX : 06-6115-8561 E-MAIL : info@dsc.co.jp
九州	〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目2-16十八銀行第一生命共同ビル9F TEL : 093-521-3373 FAX : 093-521-5225 E-MAIL : info@dsc.co.jp